第71回応用物理学会 春期学術講演会 (22a-P04-19)

TOYOHASHI

神経科学研究への応用を目指した神経プローブのハイブリッド集積技術

Hybrid integration technology of neural probes for neuroscience research

<u>篠原豪太</u>1,小田航1,西川敦2,A.Loesing2,安永弘樹1,関口寬人1 豊橋技術科学大学 1, ALLOS Semiconductors GmbH 2

2. 新たな神経科学ツール作製技術の開発

1. 脳機能解明のための半導体デバイス

マイクロLEDプローブ 針上に複数のマイクロLEDを集積した 光遺伝学に用いられるデバイス MicroLED probe Optical fiber マウスの脳 Skull 直径約1 cm マイクロLEDプローブ [1] *ξ*ô*ζ* **Brain** 深さ方向に対する多点刺激 ✓ 領域内での局所刺激 ✓ 高い時間及び空間分解能 多シャンクマイクロLEDプローブ [2]

複雑な脳神経ネットワークの解明に貢献

[1] H. Yasunaga, et al., Opt. Express, 30, 40292-40305 (2022). [2] Scharf, R, et al., Sci. Rep. 6, 28381 (2016).

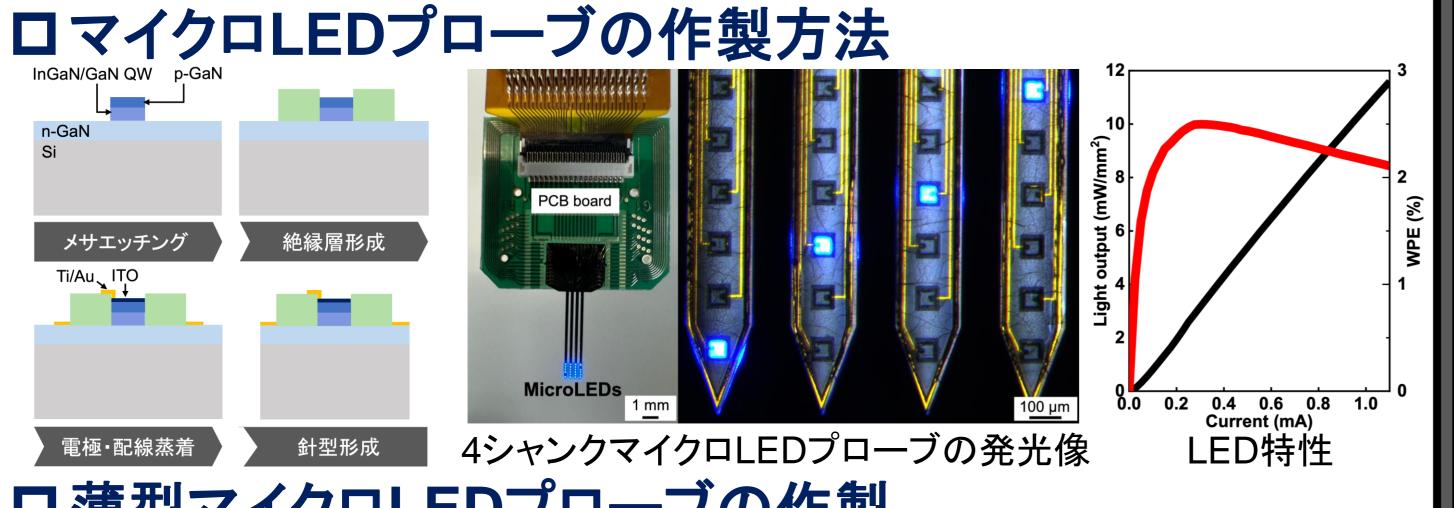
層構造への理解が大幅に進歩 Light stimulation Recording ■ プローブデバイスの課題 複数の脳細胞の 複数の脳細胞を 同時に光刺激 神経活動を観察・記録 ▶ 厚みによる発熱や測定への影響 従来の実験方法 ハイブリッド集積プローブ Neural 発熱↑・耐久性↓ Connector MicroLED electrode **PCB** board 測定の安定性↓・侵襲原 Hybrid **Probe** 脳組織への影響が少ない 薄型プローブデバイスの作製 **Probe** 設置スペースが限定的 同一細胞の制御・計測が困難

発光領域に神経電極を設置することで

LEDと神経電極を対向させた

マイクロLEDと神経電極のハイブリッド集積デバイスの開発

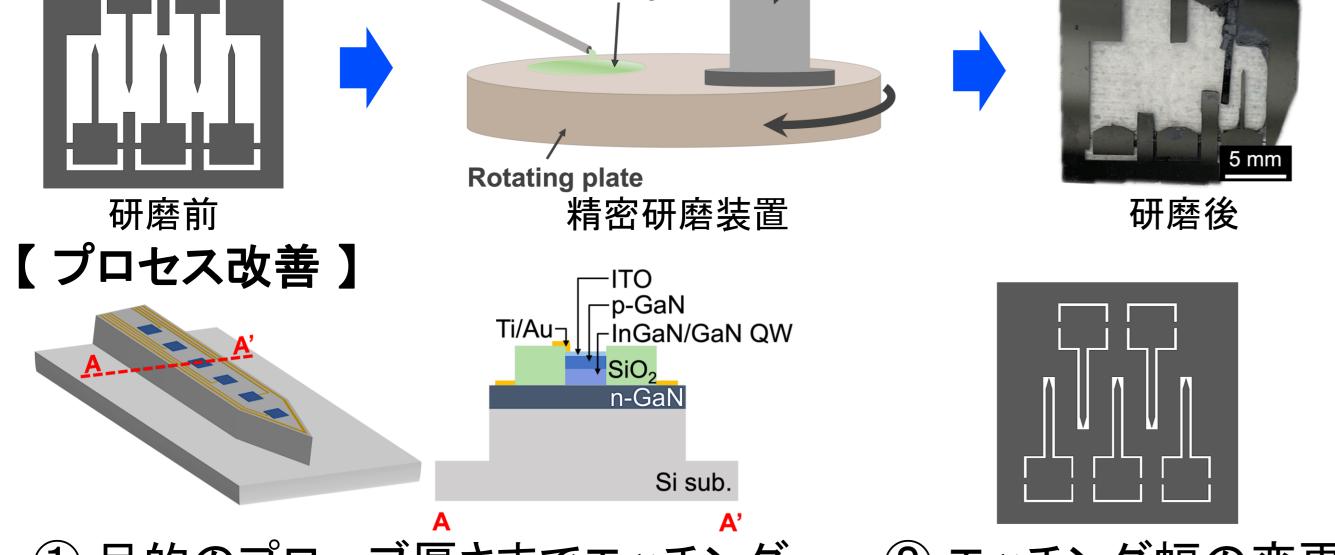
3. プローブデバイスの薄型化技術



Wafer holder

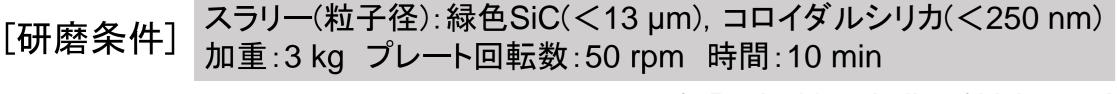
口薄型マイクロLEDプローブの作製

精密研磨装置を用いた裏面研磨を検討 【問題点】プローブの落下や折れ・欠け



Slurry

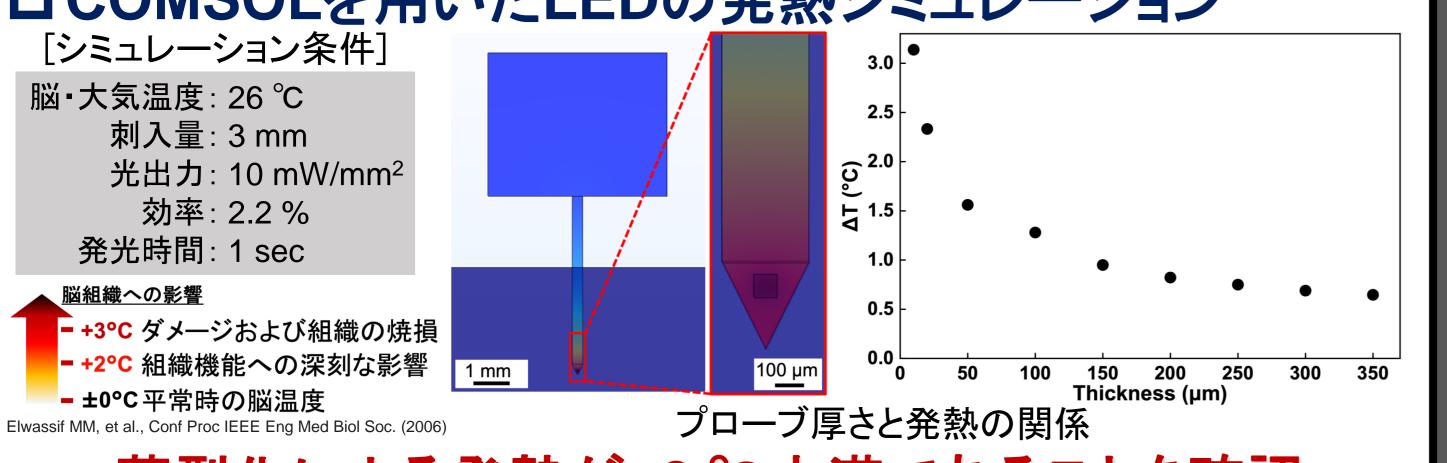
(1) 目的のプローブ厚さまでエッチング ② エッチング幅の変更 【結果】





針型構造への影響なくプローブの薄型化を実現

ロCOMSOLを用いたLEDの発熱シミュレーション



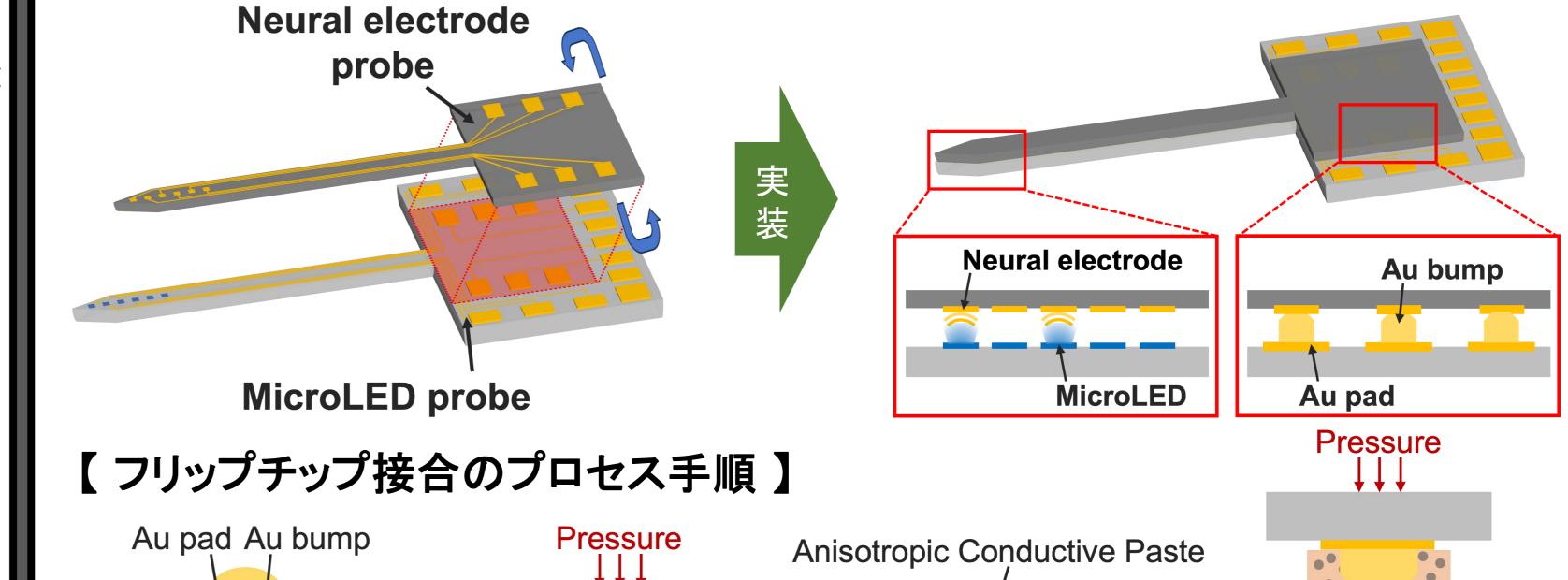
薄型化による発熱が+2℃未満であることを確認

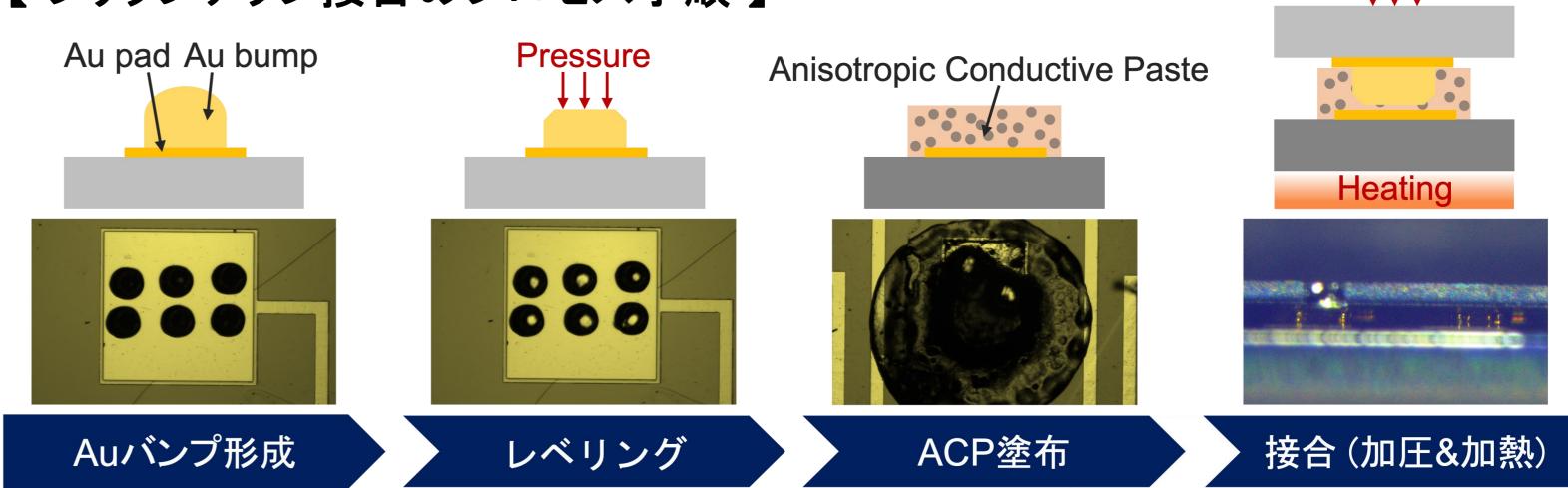
4. ハイブリッド集積技術

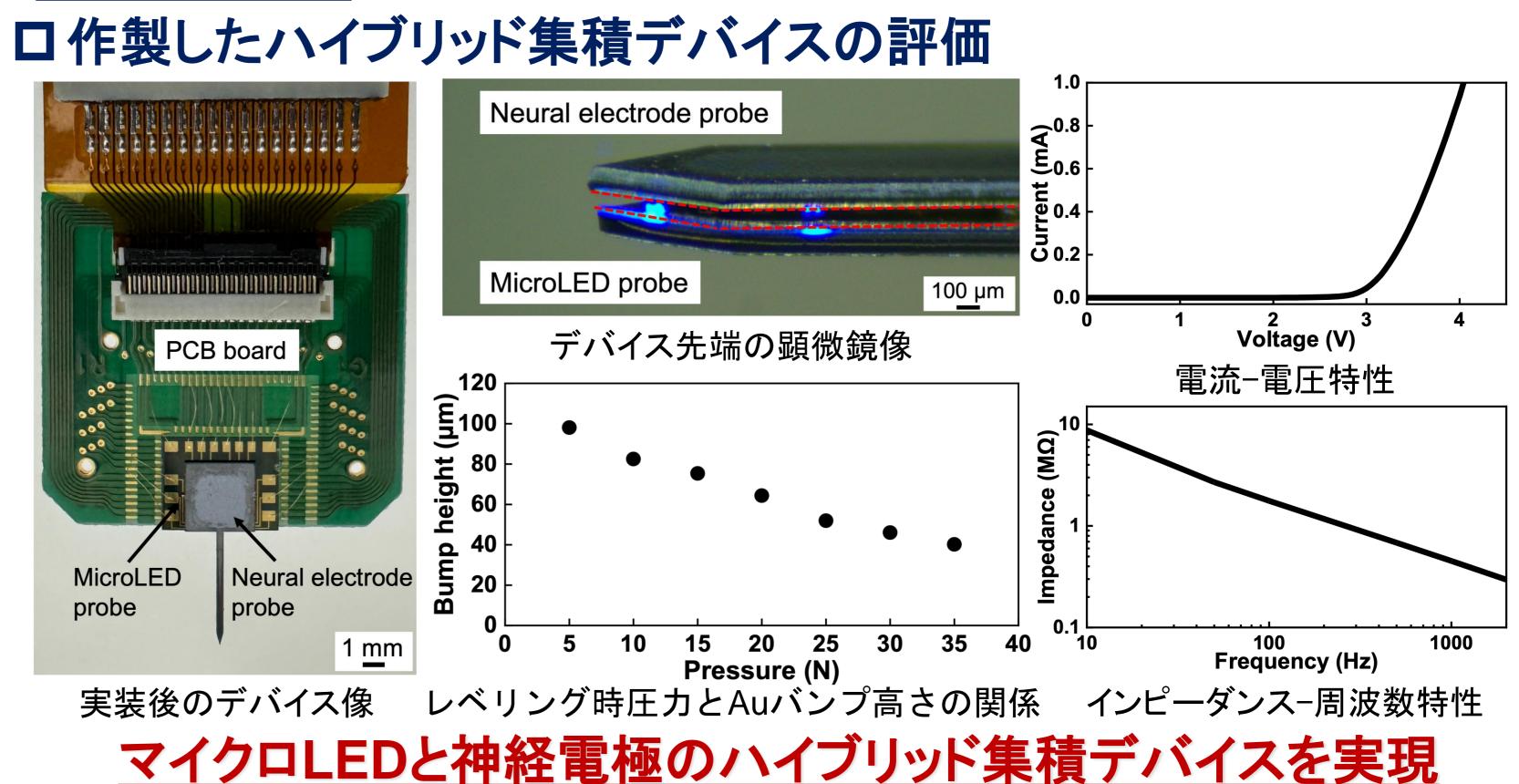
Brain

本研究の目的

ロフリップチップ接合による一体化 Auバンプの高さをデバイス間距離とする接合方法を検討







5. 総括



- 脳組織への影響が少ない薄型プローブデバイスの作製
- LEDと神経電極を対向させた積層実装技術の開発
- 結果
- 裏面研磨によりプローブの薄型化を実現
- フリップチップ接合によりハイブリッド集積デバイスを実現

神経活動の制御と計測を可能にする神経プローブの実現